证券代码：300623 证券简称：捷捷微电

**江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2021-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 ☑其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信建投证券—秦基栗、徐博沣京资本管理（北京）有限公司—王洪祥鹏华基金管理有限公司—程卿云广发基金管理有限公司—张建宾新华基金—钟俊源乘投资—胡亚男诚通基金—廖慧杰广发基金管理有限公司—刘宝川华夏久盈资产管理有限责任公司—桑永亮海富通基金管理有限公司—范庭芳东吴人寿—徐玲玲博时资本—刘雨凡长城财富资产管理股份有限公司—胡纪元光大保德信基金管理有限公司—林晓枫农银汇理基金管理有限公司—张亚楠富安达基金管理有限公司—吴战峰兴证全球基金管理有限公司—程剑建信养老金有限责任公司—宋加旺兴业基金管理有限公司—陈旭深圳悟空投资管理有限公司—陈向东民生银行—郑潇国寿安保基金管理有限公司—张帆华商基金管理有限公司—常宁东海证券资管—刘俊上海聆泽投资管理有限公司—袁伟涛华泰柏瑞基金管理有限公司—刘芷冰泰信基金管理有限公司—董季周江苏瑞华投资控股集团有限公司—章礼英广发基金管理有限公司—苏晟宇渤海人寿保险股份有限公司—金凤建信人寿保险公司有限公司—何子为赢仕投资—杨怀宇兴证全球基金管理有限公司—杨世进浙江初九投资管理有限公司—李永乐长盛基金管理有限公司—吴达和丰资本—郭志强南方基金管理有限公司—陈卓东吴基金管理有限公司—陈宪 |
| 时间 | 2021年01月28日8:30—9:30 |
| 地点 | 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号行政楼4楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事、财务总监：沈欣欣先生，公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生，公司董秘办主任：沈志鹏先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、董事会秘书张家铨介绍公司概况和2020年业绩预告情况。**首先感谢中信建投证券组织今次机构网上调研活动，欢迎大家参加今天的网络会议。我们捷捷微电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系。目前有3个工厂，6个设计团队，一个国家级实验室，3个省级工程技术中心等，IDM营收占比约82%。公司在中美贸易战及中国半导体产业亟需国产替代进口和提升国产化率的机遇与挑战下，公司快速启动并实施定增和拟可转债项目布局MOSFET、IGBT及第三代半导体器件等广阔市场新领域。2020年1月1日至2020年12月31日为预告报告期，报告期内公司聚焦主业发展方向，坚持以市场为导向，以创新为驱动，受益于产品结构升级和客户需求增长等，公司营业收入和归属于公司股东的净利润较上年同期同比增长。归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：45%-55%，盈利：27504.47万元–29401.33万元。报告期内，非经常性损益对归属于公司股东的净利润影响额约为1113.00万元，去年同期为712.00万元。二、主要交流问题**1、下游领域占比？各个领域代表性的客户有哪些？**答：公司的下游客户分布十分广泛,客户众多。按照产品的应用领域的不同,大致分为这几个类别:白色家电、小家电、漏保、电力电子模块、照明、安防、通讯、电表、汽车电子、电动工具和摩配等。公司下游客户多,并分散,应用领域宽泛。 目前下游客户情况:低压电器领域主要有正泰、德力西等;家用电器领域主要有海信、美的等;防护应用领域主要有飞利浦照明、大华股份、威胜集团、比亚迪等;电动工具领域主要有得伟、天宁等;无功补偿、电子电力模块以及摩配领域也有众多优质客户。占比情况为工控:30%;消费:30%;汽车:10%;通信:10%;安防:10%;其他:10%。谢谢!**2、今年公司的下游需求如何？目前排产到什么时候？**答：下游需求旺盛延续着去年下半年旺盛的趋势，尤其是家电、通信和安防等领域。一部分原因是海外公司因为疫情原因导致的产能利用率不足和交期超延长等，另外，就是需求端包括替代进口空间等的大幅增长。目前公司订单排产至6月份。谢谢！**3、过去一段时间的涨价情况？未来还有没有涨价的打算？**答：1.晶闸管，2020年11月16日，因部分原材料涨价等因素，产品价格作了调整（调升）；2.MOSFET，去年VD MOS、TRENCH MOS相关产品部分涨价；3.防护器件，去年有部分产品提价，约3%左右。截至到2021年1月底，公司暂没有产品提价。目前可控硅的芯片已经暂停对外销售，全部自用封测。谢谢！**4、目前MOS的封装都是由自己完成还是部分委外？定增+转债 加码车规级的封测，目前两个项目的建设进展？预计什么时候投产？**答：公司目前 MOSFET 主要采用 Fabless+封测的业务模式，公司委托芯片代工厂进行芯片制造，由于封装测试产能紧张，芯片一部分用于公司自主封测，另一部分委托外部封测厂进行封测。公司定增项目预计今年完成，由捷捷微电承建的电力电子器件生产线项目的部分产能得以释放；拟可转债项目进展：环评报告已经拿到，能评、规划、土地等手续尚在办理过程中。项目建设周期为2年左右（含基础设施及配套建设）。具体情况请关注公司的相关公告。谢谢！**5、公司第三代半导体进展情况？**答：公司已与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，截止至2021年01月28日，公司拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利4件，此外，公司还有4个发明专利尚在申请受理中此外，公司目前有少量碳化硅器件的封测，该系列产品仍在持续研究推进过程中，尚未进入量产阶段。后续进展情况，请关注公司相关公告。关于碳化硅器件和氮化镓器件，主要是“玩”材料，材料决定成本短期内很难下来，包括良率的问题等，决定了目前只能适合高端应用。从产业化的视角，材料搞起来才会有产业化进程的可能性。据了解，商用领域短时间内产业化的可能性不大，长期来看或10年左右时间，第三代半导体材料是功率半导体器件未来发展之必然。我们有耐心与信心做好技术和人才的准备，一步一台阶的走好每一步。谢谢！**6、做MOS之前我们的IDM率接近100%，而MOS采用的是fabless的方式，未来会考虑进一步完善MOS的芯片制造能力么？**答：我们始终认为IDM模式是功率半导体的核心竞争力之一，当然，在一些应用领域，阶段性的分工并结合安全边际与边际效应等因素同样具备一定的性价比。我们现在的产能和封测能力能满足未来几年一定的复合增长,结合目前市场情形，公司未来产能还需要一定的扩充，阶梯式发展模式比较适合我们公司现状，包括团队建设等。当然，通过定增项目及拟可转债项目等建设，我们的产能与产能利用率会有一定程度的提升，从而进一步推动公司的可持续发展。谢谢！**7、预计这个景气周期能持续多久？**答：整个半导体产业2020年第三、四季度同比增幅比较大，若用去年第四季度的情形来预测2021年的产业趋势，应该是不错的，况且受疫情影响，海外工厂的产能不足与交期延后的原因和下游需求端（包括进口替代）增长等因素的影响，就功率半导体产业而言，预计今年的情况是可预期的。谢谢！公司董秘张家铨先生最后表示，欢迎来公司工厂调研与指导。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021-01-28 |